

科技行业

COMPUTEX 2026 展会及 GTC Taipei 前瞻：聚焦 AI 与互联

- ▶ **COMPUTEX 2026 展会及 GTC Taipei 将于 6 月 1 日至 5 日于台北举行**
- ▶ **展会主题为“AI Together”，核心将围绕 AI，聚焦包括芯片和机架 (GPU/CPU/LPU)、互联 (CPO/midplane)、800V DC power、液冷、边缘设备、AI 硬件、机器人和具身智能**

COMPUTEX 2026 (2026 台北国际电脑展) 和 GTC Taipei 将于 6 月 1 日至 5 日在台北举行，届时多家行业龙头公司 (英伟达、高通、ARM、Marvell、英特尔等) 的 CEO 将发表主题演讲，数千家供应链企业将参与展会展示。本次大会的主题是“AI Together” (AI 携手共进)。大会 (包括主题演讲和展会展示) 的重点可能集中在以下方面：(1) AI 基础设施，涵盖 GPU/CPU/LPU 芯片和机架 (英伟达、高通、英特尔、AMD)、互联技术 (英伟达、Marvell、鸿腾精密、安费诺、Bizlink)、电源 (Vertiv、Delta、Bizlink)、液冷 (Aurus、富士康)、服务器和数据中心 (联想、戴尔、惠普)；(2) 边缘 AI 设备和硬件 (高通、英特尔、ARM、联发科、联想、华硕、宏碁)；(3) 机器人和具身智能。

AI 基础设施、计算和互联技术

英伟达：Rubin GPU/Vera CPU/LPU 及机架将为焦点，MGX 供应商名录亦是重点关注。英伟达将于 6 月 1 日以 CEO 黄仁勋的主题演讲拉开帷幕，进一步阐述其 AI “五层” 结构，并发布 Vera Rubin (VR) 架构的更多细节。**Vera CPU** 是 NVIDIA 面向 AI 推理的 ARM 架构 CPU，其性能比 x86 架构高 1.5 倍，能效高 2 倍，机架密度高 4 倍。英伟达可能会展示其 Vera Rubin NVL72 机架式 AI 超级计算机，以及 Jetson Thor 边缘 AI 模块和 Alpamayo 自动驾驶汽车平台。还可能将发布更多关于 GPU/CPU/LPU 和机架的更新信息。此外，英伟达 N1/N1X SoC 芯片 (基于 ARM 架构，与联发科合作开发) 也有望亮相。光互连 (**CPO 交换机和硅光**) 和机器人技术 (包括具身智能) 也可能成为关注焦点。英伟达还可能将重点展示具身智能和 AI 工厂，将超级计算与现实世界的机器人和工业自动化相结合。与此同时，英伟达 **MGX 生态系统的供应商名录更新** (新增和移除的供应商) 将是另一个值得关注的领域。

英特尔：在 CPU 上行周期中占据重要地位。英特尔 CEO 将于 6 月 2 日发表主题演讲，或重点介绍其 **18A 制程工艺** 以及涵盖客户端、边缘和数据中心的全栈 AI 芯片产品线。其或将展示搭载 Arc G3 GPU 的 Panther Lake 移动/手持设备芯片，用于游戏移动设备，并预览将于 2026 年底发布的桌面 CPU **Nova Lake** (Core Ultra 4)。在服务器方面，英特尔或将重点介绍 **Clearwater Forest** (Xeon)，这是一款针对 AI/云推理优化的 288 核 18A 处理器。CPU 在 AI 推理时代的重要性值得关注，如今它与 GPU 的互补比例已达到 1:1。

Marvell：关注互联技术升级和光通信领域。CEO 将于 6 月 2 日发表主题为“AI 扩展的未来取决于互联”的主题演讲。此次展会旨在展示 Marvell 在人工智能数据中心互连领域的领先地位，包括业界首款 1.6T ZR/ZR+可插拔产品和 2nm 相干 DSP，以及对扩展人工智能集群至关重要的 800G 交换机和 CXL3.0 控制器。其核心重点是与英伟达达成的 20 亿美元合作，旨在扩展 **NVLink Fusion 和硅光技术**，从而解决高性能计算中的数据瓶颈问题。Marvell 还将展示 PCIe 6.0 SSD 控制器和针对边缘/服务器工作负载优化的 AI SoC，以及可降低多云 AI 部署中延迟和功耗的 COLORZ 光互连平台。

ARM：边缘 AI 的基石，CPU 领域的新晋但潜力巨大。ARM 将在 6 月 2 日进行 CEO 主题演讲。ARM 此前正式进军商用芯片市场，发布了 ARM AGI CPU。这是一款 3nm、136 核的数据中心芯片，专为智能体 AI 设计，机架性能是 x86 架构的两倍。本次主题演讲将聚焦 ARM 作为 Agent AI 智能的基础，重点展示 **Neoverse V3 内核和 ARM V10 架构** 在高性能服务器领域的进步。演讲还将着重阐述基于 ARM 的 Windows 生态系统的发展，支持英伟达的 N1X 和高通的骁龙 X 平台，以及面向工业和机器人应用的边缘人工智能解决方案。此外，演讲或将重点介绍 ARM 与 Meta 在通用人工智能 (AGI) CPU 开发方面的合作，以及 ARM 为大规模生产提供的 ODM 服务。

边缘 AI 硬件和设备

高通：Agent AI 和边缘计算的核心。首席执行官将于 6 月 1 日发表主题为“智能体之年”的主题演讲，重点强调 Agent AI 和边缘到云人工智能的融合。高通或将重点展示 **骁龙 X Elite/X Plus 平台**，凭借超过 750 款原生应用和 1400 多款支持游戏，以及用于本地生成式人工智能推理的 45TOPS NPU 性能，推动 Windows-on-ARM 的发展。高通还将预览面向 Copilot+ AI PC 的下一代 **骁龙 8 Gen 4** 处理器，确保在纤薄设计中实现更高的能效和 30 小时的电池续航时间。此外，高通还将通过与沙特阿拉伯人工智能公司 Humain 的合作，拓展了其在数据中心 CPU 领域的业务，并展示了 Dragonwing 连接解决方案。

AMD：专注于 AI PC 和边缘计算，重点强调能够自主运行人工智能任务的“Agent PC”。AMD 预计将展示 **Ryzen 8000 (Zen 5)** 桌面/移动 CPU，该系列产品将提供更高的 IPC 和 AI 优化的能效，并集成 Ryzen AI NPU 以支持 OEM 参考设计。在数据中心领域，AMD 重点展示了用于 AI 工作负载的 EPYC 9004 服务器更新以及 MI300X 加速器。

联发科：与英伟达合作，赋能边缘设备。联发科将展示备受期待的 N1X 系列 AI PC 处理器，该处理器由联发科与英伟达联合开发，采用台积电 3nm 工艺制造，旨在打造集成 Blackwell GPU 的 Windows on ARM 芯片。此外，双方的合作还延伸至汽车领域，推出了 Dimensity Auto 平台，引入了先进的、智能化的 AI 驱动的驾驶舱环境。联发科还将通过发布 WiFi 8 芯片巩固其在网络领域的领先地位，该芯片集成了 NPU 智能，可动态缓解干扰。

华硕和宏碁：AI PC 的推动者和领导者。华硕预计将展示其涵盖企业、创作者、医疗保健和日常计算的统一生态系统，以及备受瞩目的下一代 AI PC 产品，这些产品专为混合型办公人员和创作者优化。宏碁则着重提升 AI 硬件的易用性，可能将推出涵盖消费级和商用级产品的全新 Copilot+ PC，重点关注设备端本地化管理、增强型散热管理以支持持续的 NPU 工作负载以及环保制造。

联想将着力连接消费级设备和企业级部署。联想可能将展示全新的 ThinkPad 和 Yoga AI PC 产品组合，以及边缘到云的服务器基础设施。联想将重点展示混合 AI 配置，演示企业如何在本地化边缘基础设施上安全地运行数据敏感型 AI 模型，而不是完全依赖公有云。

其他关注点与影响

其他值得关注的领域和趋势。COMPUTEX 首次设立了专门的机器人展区，重点展示自主移动机器人 (AMR)、无人机和工业计算机视觉系统。这表明人工智能浪潮正迅速迈入部署阶段，具身智能尤其引人注目。由于台积电的 CoWoS 产能分配紧张，未来可能会出现用于服务器架构的替代封装方案，以及用于绕过传统数据中心瓶颈的高带宽光互连 (硅光技术)。

COMPUTEX 2026 重点主题演讲和活动日程

活动	时间	演讲嘉宾	地点	重点关注
6月1日				
NVIDIA GTC 台北 2026 主题演讲	11:00am – 12:30pm	黄仁勋 (英伟达 CEO)	台北流行音乐中心 (TMC)	Vera Rubin, Blackwell, 具身智能、机器人, AI 工厂, Agent AI
全球记者会	14:00pm – 14.15pm	—	台北南港展览馆 2 馆 7 楼 701CDGH 会议室	—
高通 CEO 主题演讲 "The Year of Agents"	14:15pm – 15:15pm	Cristiano R. Amon (高通 CEO)	台北南港展览馆 2 馆 7 楼 701CDGH 会议室	Agent AI, 边缘计算, AI PC, 骁龙 (Snapdragon)
6月2日				
开幕典礼	10:00am – 11:00am	—	台北南港展览馆 1 馆 4 楼展 场 M 区门厅	—
ARM CEO 主题演讲 "The Agentic AI Shift"	11:00am – 12:00pm	Rene Haas (ARM CEO)	台北寒舍艾美酒店	Agentic AI 发展, 云到端, 生态系统, Windows-on-ARM
Marvell CEO 主题演讲 "The Future of AI Scaling Depends on Connectivity"	10:30am – 11:30am	Matt Murphy (Marvell CEO); 黄仁勋 (英伟达 CEO)	台北南港展览馆 2 馆 7 楼 701CDGH 会议室	互联技术, AI 数据中心互 联, 光通讯
英特尔 CEO 主题演讲 "Advancing the Next Era of AI-Driven Computing"	13:30pm – 14:30pm	陈立武 (英特尔 CEO)	台北南港展览馆 2 馆 7 楼 701ABEF 会议室	芯片制造工艺, CPU, AI PC, 边缘计算
InnoVEX 2026 开幕典礼	13:30pm – 14:30pm	—	台北南港展览馆 2 馆 4 楼 S 区 InnoVEX Center Stage	—
6月4日				
恩智浦 CEO 主题演讲	10:30am – 11:30am	Rafael Sotomayor (恩智浦 CEO)	台北南港展览馆 2 馆 7 楼 701CDGH 会议室	边缘 AI, 物理智能和具身 智能, 安全性和可拓展性

资料来源: COMPUTEX 官网, 英伟达, 高通, ARM, 英特尔, Marvell, 恩智浦, CCBIS

评级定义:

优于大市——于未来 12 个月预期回报为高于 10%

中性——于未来 12 个月预期回报在-10%至 10%之间

弱于大市——于未来 12 个月预期回报低于-10%

分析师证明:

本文作者谨此声明: (i) 本文发表的所有观点均正确地反映作者有关任何及所有提及的证券或发行人的个人观点, 并以独立方式撰写; (ii) 其报酬没有任何部分曾经, 目前或将来会直接或间接与本文发表的特定建议或观点有关; 及 (iii) 该等作者没有获得与所提及的证券或发行人相关且可能影响该等建议的内幕信息/非公开的价格敏感数据。本文作者进一步确定 (i) 他们或其各自的关联人士 (定义见证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则) 没有在本文发行日期之前的 30 个日历日内曾买卖或交易过本文所提及的股票, 或在本文发布后 3 个工作日 (定义见《证券及期货条例》(香港法例第 571 章) (内将买卖或交易本文所提及的股票); (ii) 他们或其各自的关联人士并非本文提及的任何公司的雇员; 及 (iii) 他们或其各自的关联人士没有拥有本报告提及的证券的任何金融利益。

免责声明:

本文由建银国际证券有限公司编写。建银国际证券有限公司为建银国际 (控股) 有限公司 (「建银国际控股」) 和中国建设银行股份有限公司 (「建行」) 全资附属公司。本文内容之信息相信从可靠之来源所得, 但建银国际证券有限公司, 其关联公司及/或附属公司 (统称「建银国际证券」) 不对任何人士或任何用途就本文信息的完整性或准确性或适切性作出任何形式担保、陈述及保证 (不论明示或默示)。当中的意见及预测为我们于本文目的判断, 并可更改, 而无需事前通知。建银国际会酌情更新其研究报告, 但可能会受到不同监管的阻碍。除个别行业报告为定期出版, 大多数报告均根据分析师的判断视情况不定期出版。预测、预期及估值在本质上是推理性的, 且可能以一系列偶发事件为基础。读者不应将本文中的任何预测、预期及估值视作为建银国际证券或以其名义作出的陈述或担保, 或认为该等预测、预期或估值, 或基本假设将实现。投资涉及风险, 过去的表现并不反映未来业绩。本文的信息并非旨在对任何有意投资者构成或被视为法律、财务、会计、商业、投资、税务或任何专业意见, 因此不应因而作为依据。本文仅作参考资讯用途, 在任何司法管辖权下的地方均不应被视为购买或销售任何产品、投资、证券、交易策略或任何类别的金融工具的要约或招揽。建银国际不对收件人就本报告中涉及的证券的可用性 (或相关投资) 做任何陈述。本文中提及的证券并非适合在所有司法管辖权下的地方或对某些类别的投资者进行销售。建银国际证券及其它任何人仕对使用本文或其内容或任何与此相关产生的任何其它情况所引发的任何损害或损失 (不论直接的、间接的、偶然的、示范性的、补偿性的、惩罚性的、特殊的或相应发生的) 概不负上任何形式的责任。本文所提及的证券、金融工具或策略并不一定适合所有投资者。本文作出的意见及建议并没有考虑有意投资者的财政情况、投资目标或特殊需要, 亦非拟向有意投资者作出特定证券、金融工具及策略的建议。本文的收件人应仅将本文作为其做出投资决定时的其中一个考虑因素, 并应自行对本文所提及的公司之业务、财务状况及前景作出独立的调查。读者应审慎注意 (i) 本文所提及的证券的价格和价值以及来自该等证券的收益可能有所波动; (ii) 过去表现不反应未来业绩; (iii) 本文中的任何分析、评级及建议为长期性质的 (至少 12 个月), 且与有关证券或公司可能出现的表现的短期评估无关联。在任何情况下, 未来实际业绩可能与本文所作的任何前瞻性声明存在重大分歧; (iv) 未来回报不受保证, 且本金可能受到损失; 以及 (v) 汇率波动可能对本文提及的证券或相关工具的价值、价格或收益产生不利影响。应注意的, 本文仅覆盖此处特定的证券或公司, 且不会延伸至此外的衍生工具, 该等衍生工具的价值可能受到诸多因素的影响, 且可能与相关证券的价值无关。该等工具的交易存在风险, 并不适合所有投资者。尽管建银国际证券已采取合理的谨慎措施确保本文内容提及的事实属正确, 而前瞻性声明、意见及预期均基于公正合理的假设上, 建银国际证券不能对该等事实及假设作独立的复核, 且建银国际证券概不对其准确性、完整性或正确性负责, 亦不作任何陈述或保证 (不论明示或默示)。除非特别声明, 本文提及的证券价格均为当地市场收盘价及仅供参考而已。没有情况表明任何交易可以或可能依照上述价格进行, 且任何价格并不须反映建银国际证券的内部账簿及记录或理论性模型基础的估值, 且可能基于某些假设。不同假设可能导致显著不同的结果。任何此处归于第三方的声明均代表了建银国际对由该第三方公开或通过认购服务提供的数据、信息以及/或意见的阐释, 且此用途及阐释未被第三方审阅或核准。除获得所涉及的第三方书面同意外, 禁止以任何形式复制及分发该等第三方的资料内容。收件人须对本文所载之信息的相关性、准确性及足够性作其各自的判断, 并在认为有需要或适当时就作出独立调查。收件人如对本文内容有任何疑问, 应征求独立法律、财务、会计、商业、投资和/或税务意见并在做出投资决定前使其信纳有关投资符合自己的投资目标和投资界限。

使用超链接至本文提及的其它网站或资源 (如有) 的风险由使用者自负。这些链接仅以方便和提供信息为目的, 且该等网站内容或资源不构成本文的一部分。该等网站提供的内容、精确性、意见以及其它链接未经过建银国际证券的调查、核实、监测或核准。建银国际证券明确拒绝为该等网站出现的信息承担任何责任, 且不对其完整性、准确性、适当性、可用性及安全性作任何担保、陈述及保证 (不论明示或默示)。在进行任何线上或线下访问或与这些第三方进行交易前, 用户须对该等网站全权负责查询、调查和作风险评估。使用者对自身通过或在该等网站上进行的活动自负风险。建银国际证券对使用者可能转发或被要求通过该等网站向第三方提供的任何信息的安全性不做担保。使用者已被认为不可不撤销地放弃就访问或在该等网站上进行互动所造成的损失向建银国际证券索赔。

与在不同时间或在不同市场环境下覆盖的其它证券相比，建银国际根据要求可能向个别客户提供专注于特定证券前景的专门的研究产品或服务。虽然在此情况下表达的观点可能不总是与分析师出版的研究报告中的长期观点一致，但建银国际证券有防止选择性披露的程序，并在观点改变时向相关读者更新。建银国际证券亦有辨别和管理与研究业务及服务有关联的潜在利益冲突的程序，亦有中国墙的程序确保任何机密及/或价格敏感信息可被恰当处理。建银国际证券将尽力遵守这方面的相关法律和法规。但是，收件者亦应注意中国建设银行、建银国际证券及其附属机构以及/或其高级职员、董事及雇员可能会与本文所提及的证券发行人进行业务往来，包括投行业务或直接投资业务，或不时自行及/或代表其客户持有该等证券（或在任何相关的投资中）的权益（和/或迟后增加或处置）。因此，投资者应注意建银国际证券可能存在影响本文客观性的利益冲突，而建银国际证券将不会因此而负上任何责任。此外，本文所载信息可能与建银国际证券关联人士，或中国建设银行的其它成员，或建银国际控股集团公司发表的意见不同或相反。本文中所提及的产品、投资、证券、金融工具或行业板块，仅为建银国际的机构和专业客户所提供，本文不应提供给零售客户。

如任何司法管辖权区的法例或条例禁止或限制建银国际证券向您提供本文，您并非本文的目标发送对象。在阅读本文前，您应确认建银国际证券根据有关法例和条例可向您提供有关投资的研究资料，且您被允许并有资格接收和阅读本文。尤其本文只可分发给予依据美国证券法许可建银国际证券分发的指定美国人士，但不能以其它方式直接或间接分发或传送至美国或任何其他美国人士。任何本文接收者中的美国人士（根据美国《交易法》或 1986 年《美国国内税法（修订）》的定义），如希望根据此处提供的信息进行任何证券买卖或相关金融工具的交易，则此类交易仅限转交与，且仅应通过建银国际海外（美国）公司进行。除非根据适用法律，本文同样不能直接或间接分发或传送至日本和加拿大，及中国境内的公众人士（就本文而言，不包括香港、澳门及台湾）。严禁以任何方式擅自将本研究报告的全部或任何部分再复制或分发予任何人士，建银国际证券对第三方再分发本研究报告的行为概不承担任何责任。若本文已经通过电子途径，如电子邮件分发，那该途径并非保证安全或无误，因为信息可能被拦截、损坏、丢失、破坏、迟达或不完整，或包含病毒。因此，建银国际证券对电子传送对本文可能产生的任何错误，或内容遗漏不负责任。本文中所载的披露由建银国际证券编制，应按香港法律管辖及解释。

在新加坡的分发：本文中的信息/研究由建银国际（新加坡）有限公司（建银国际新加坡）（公司注册号 201531408W）的外国分支机构建银国际证券有限公司（“建银国际证券”）提供。建银国际新加坡持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照，可用于基金管理、资本市场产品交易（特别是证券和集体投资计划）并提供托管服务，并且是新加坡 Financial Advisers Act 规定的通过发布或颁发研究分析或研究报告的豁免财务顾问。建银国际证券可以根据新加坡 Financial Advisers Regulations 第 32C 条之与建银国际新加坡的安排分发信息/研究报告。建银国际证券在香港获得了提供此类信息/研究报告的许可。新加坡接收者应通过+ 65-68071880 与建银国际新加坡联系，解决分发此信息引起的或与之相关的事宜。

©建银国际证券有限公司 2026。本文所使用的标志、标识和徽章及公司名称「建银国际证券有限公司」均属于中国建设银行、建银国际控股和/或建银国际证券的注册及非注册商标。版权所有，违者必究。除非另有说明，本文中的所有材料的版权为建银国际证券所有。未经建银国际证券的书面同意，本文或本文中的任何部分不得复制、出售或再次派发。

以上声明以英文版本为准。

建银国际证券有限公司

香港中环干诺道中 3 号中国建设银行大厦 12 楼

电话：(852) 3911 8000 / 传真：(852) 2537 0097